2012年1月期
第3四半期 決算説明会

2011年 12月 7日

株式会社 SUMCO

見通しに関する注意事項

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

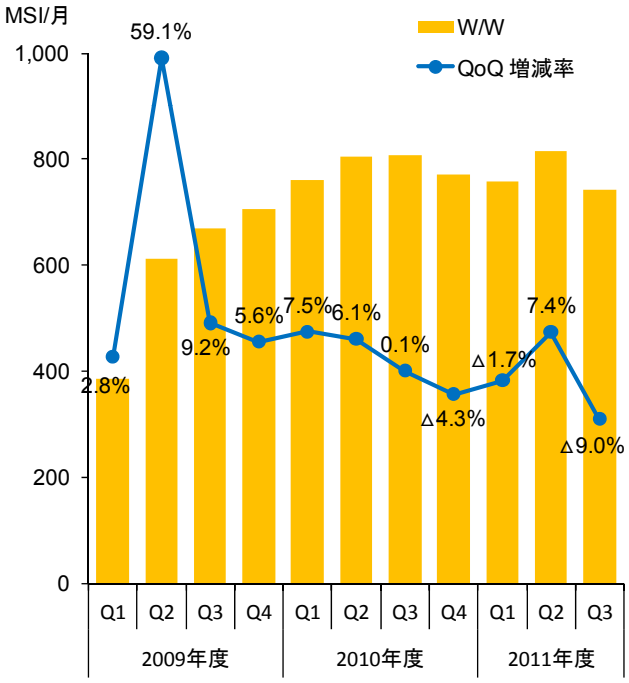
目次

- 2011年度 第3四半期決算の概要（連結）
  1. 当社を取り巻く環境
  2. 2011年度　第3四半期業績（連結）
  3. 営業利益増減分析
  4. 収益基盤強化施策の効果（対2010年度）
  5. バランス・シート
  6. キャッシュ・フロー
- 2011年度　業績予想の修正（連結）
  1. 事業環境の変化
  2. 下期業績予想の修正
  3. 営業利益増減分析
- 参考資料

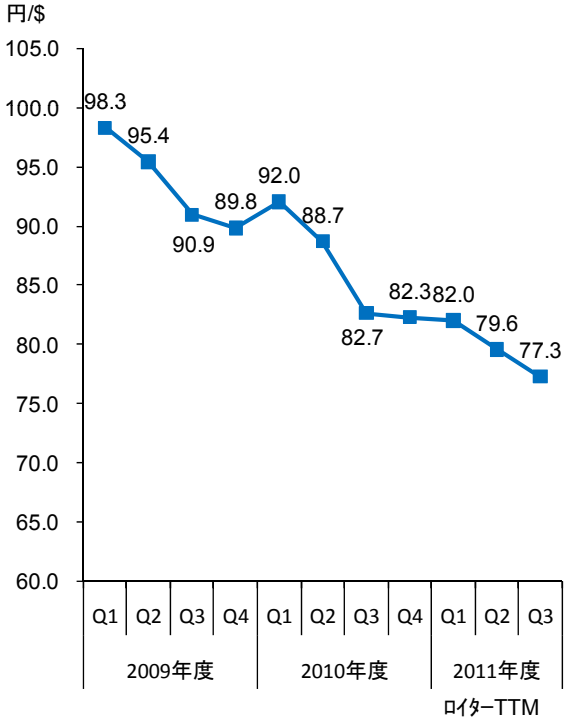
2011年度
第3四半期決算概要（連結）

1. 当社を取り巻く環境

■ 半導体用シリコンウェーハ 世界出荷面積推移



■ 為替レートの推移



2. 2011年度 第3四半期 業績(連結)

■ 売上高 623億円、営業利益 10億円、経常損失 3億円

(単位:億円)

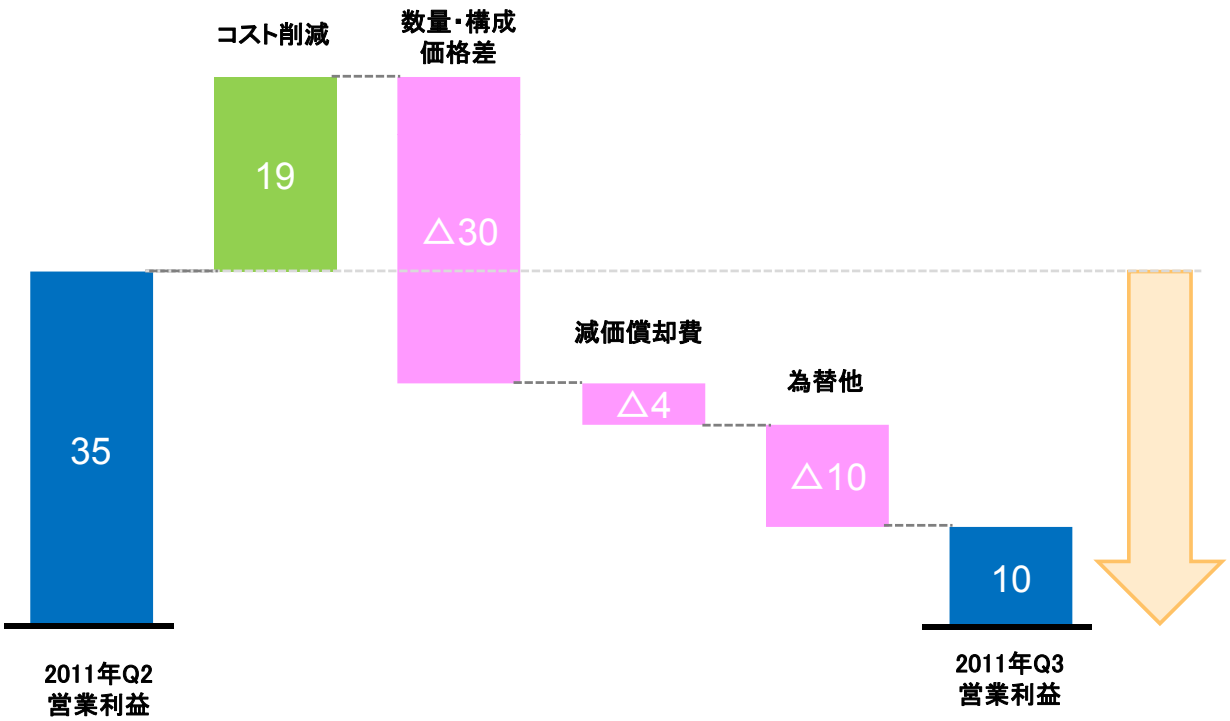
		2010年度	2011年度				増減
		Q3累計 ①	Q3累計 ②	内Q2 ③	内Q3 ④	増減 ④−③	②−①
売上高		2,130	1,972	692	623	△ 69	△ 158
営業利益		△ 25	64	35	10	△ 25	89
営業外	減価償却費	△ 90	△ 24	△ 6	△ 6	0	66
	その他	△ 52	△ 28	△ 16	△ 7	9	24
経常利益		△ 167	12	13	△ 3	△ 16	179
特別損益		△ 6	注1 △ 18	0	0	0	△ 12
税金費用等		△ 165	△ 15	△ 7	△ 5	2	150
純利益		△ 338	△ 21	6	△ 8	△ 14	317
設備投資額(検収ベース)		85	148	40	76	36	63
減価償却費		588	388	128	132	4	△ 200
EBITDA	注2	495	448	165	142	△ 23	△ 47
為替レート(円/US$)		89.1	80.4	81.2	77.2	△ 4.1	△ 8.7

(注1) 特別損失には東日本大震災の被災に係わる災害損失12億円を含む
(注2) EBITDA=営業利益+営業内減価償却費+のれん償却額

3. 営業利益増減分析(2011年Q2→2011年Q3)

■ 営業利益差異　△25億円

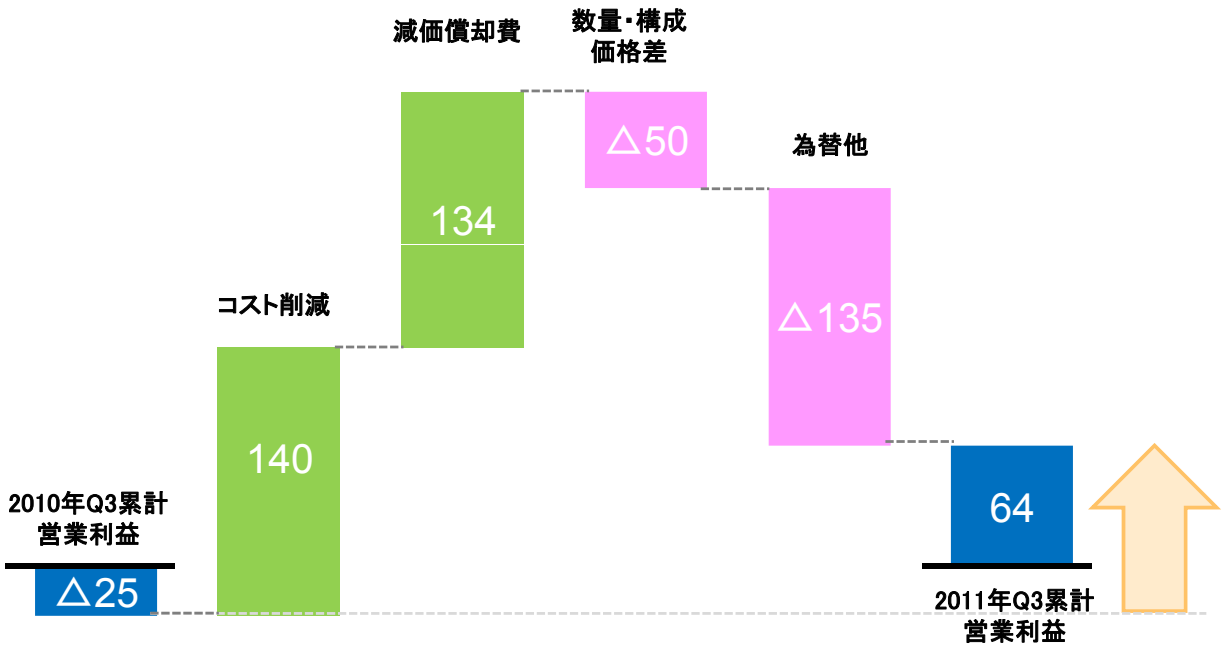
(単位:億円)



3. 営業利益増減分析(2010年Q3累計→2011年Q3累計)

■ 営業利益差異　+89億円

(単位:億円)



4. 収益基盤強化施策の効果（対2010年度）

■ 3Q累計のコスト削減　161億円、減価償却費低減　186億円

（単位：億円）

	2011年度		2013年度
	Q3累計実績	通期計画	目標
固定費の削減	53	70	100
生産性の改善	108	116	290
合計	161	186	390

	2011年度		2013年度
	Q3累計実績	通期計画	目標
減価償却費の低減	186	195	300

5. バランスシート

■ 対前年度末、総資産 △382億円、負債 △303億円

（単位：億円）

		2011年1月末 ①	2011年7月末 ②	2011年10月末 ③	増減 ③－①
	現預金等	538	386	285	△ 253
	有形・無形固定資産	2,918	2,720	2,622	△ 296
	繰延税金資産	319	316	313	△ 6
	その他	1,842	1,998	2,015	173
総資産		5,617	5,420	5,235	△ 382
	有利子負債	2,648	2,454	2,320	△ 328
	その他	808	833	833	25
負債		3,456	3,287	3,153	△ 303
	資本金・資本剰余金	2,033	2,033	2,033	0
	利益剰余金	18	5	△ 2	△ 21
	その他	110	95	51	△ 58
純資産		2,161	2,133	2,082	△ 79

自己資本比率	35.0%	35.9%	36.5%
D/E レシオ（グロス）	1.3	1.3	1.2
D/E レシオ（ネット）	1.1	1.1	1.1

6. キャッシュフロー

■ Q3累計のキャッシュフローは営業キャッシュフロー +163億円、投資キャッシュフロー △86億円、フリーキャッシュフロー +77億円

（単位：億円）

		2011年度 Q3累計
	税引前純損益	△ 5
	減価償却費	388
	事業構造改善費用	△ 51
小計		332
運転資金等増減　他		△ 169
営業キャッシュフロー		163
設備投資（検収ベース）		△ 148
設備債務増減他		62
投資キャッシュフロー		△ 86
フリーキャッシュフロー		77
財務キャッシュフロー		△ 327
現預金残高		285
有利子負債残高		2,320

2011年度
業績予想の修正（連結）

1. 事業環境の変化

1. 半導体用シリコンウェーハ

- スマートフォンやタブレットは引き続き拡大しているが、成長率の鈍化懸念も出てきている
- PCは低成長、タイの洪水被害によるHDD調達リスクも発生、DRAMは生産調整が継続する見込み
- 各国の消費刺激策の終了や景気後退懸念により、デジタル家電など民生機器需要が停滞を始め、マイコンやパワー半導体などの生産調整が生じ、200mm以下の需要が急減している

2. ソーラー用シリコンウェーハ

- 市場環境は好転せず、価格下落が継続
- 当社は技術開発・コスト削減策を実施中

2. 下期業績予想の修正

■ 半導体用小径シリコンウェーハ需要の急減により売上高が減少

（単位：億円）

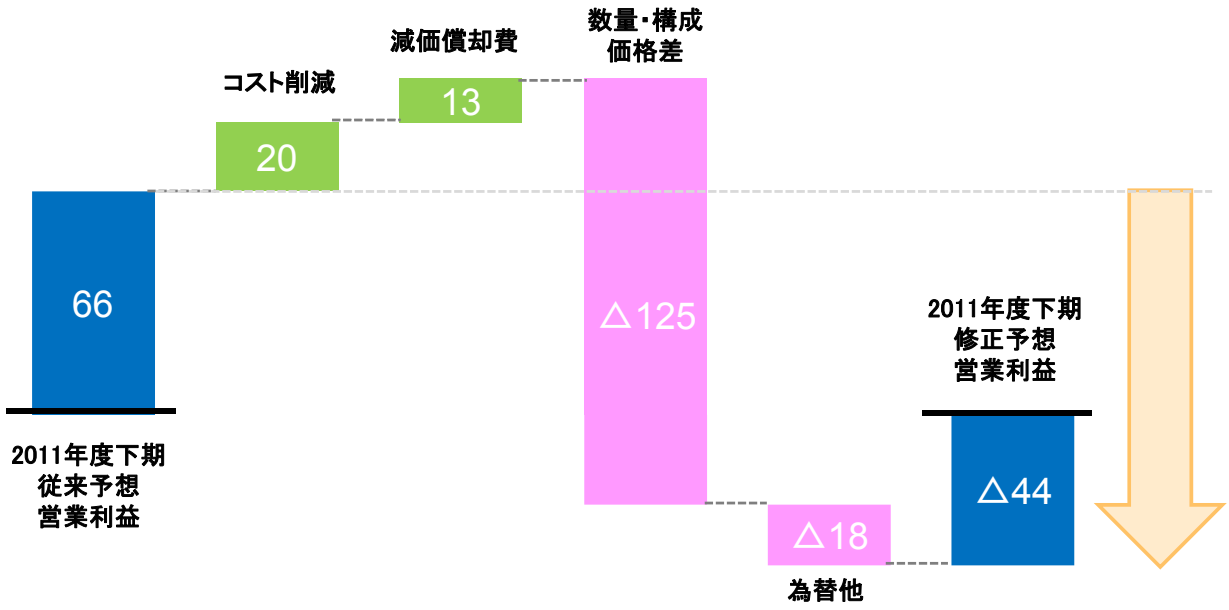
		従来予想 下期 ①	修正予想 Q3 実績	修正予想 Q4 予想	修正予想 下期 ②	下期予想 差異 ②－①
売上高		1,371	623	498	1,121	△ 250
営業利益		66	10	△ 54	△ 44	△ 110
営業外	減価償却費	△ 7	△ 6	△ 10	△ 16	△ 9
	その他	△ 24	△ 7	△ 8	△ 15	9
経常利益		35	△ 3	△ 72	△ 75	△ 110
特別損益		0	0	0	0	0
税金費用等		3	△ 5	3	△ 2	△ 5
純利益		38	△ 8	△ 69	△ 77	△ 115
設備投資額（検収ベース）		148	76	72	148	0
減価償却費		268	132	132	264	△ 4
EBITDA	注1	339	142	74	216	△ 123
為替レート（円/US$）		80.0	77.2	77.0	77.1	△ 2.9

（注1） EBITDA＝営業利益＋営業内減価償却費＋のれん償却額

3. 営業利益増減分析(2011年下期 従来予想との比較)

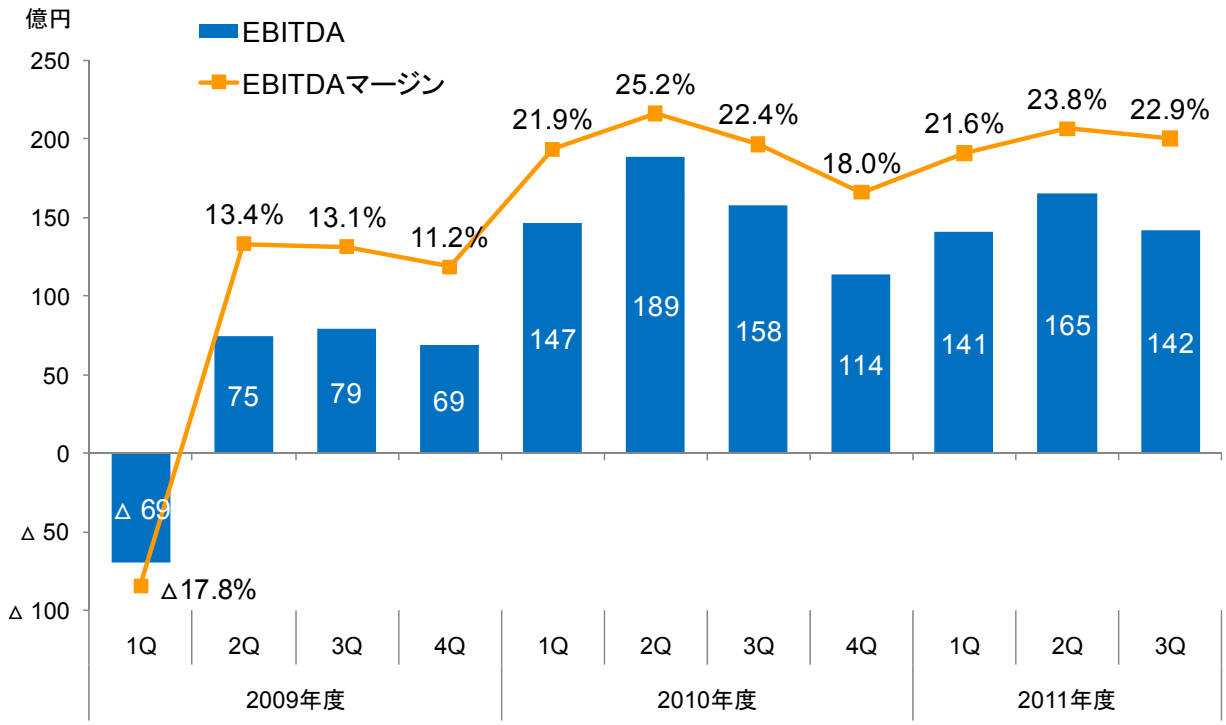
■ 営業利益差異　△110億円

(単位:億円)



参考資料

参考資料:EBITDA

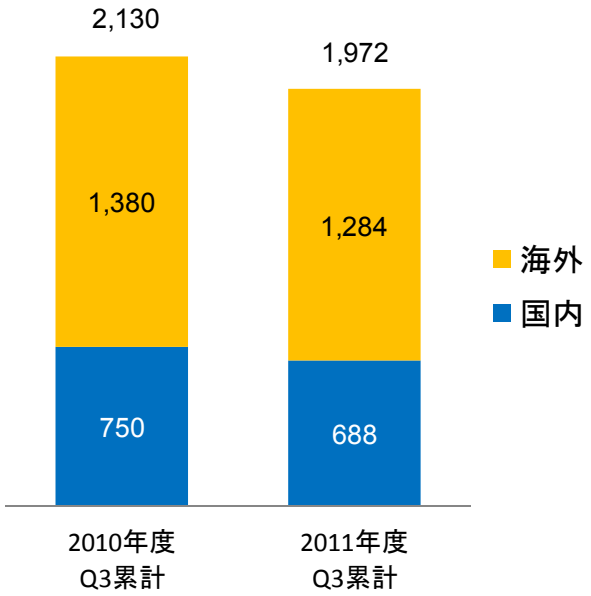


（注）EBITDA＝営業利益＋営業内減価償却費＋のれん償却額

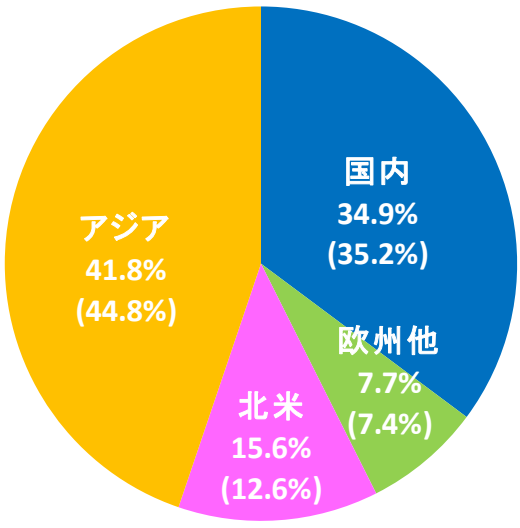
参考資料:売上構成

■ 国内外売上

（単位:億円）



■ 地域別売上比率(Q3累計)



（ ）内は前年同期実績

Developing Technology to Create the Future